

---

## INSCRIPTION INFORMATION & CGV (+ en annexe le programme de la formation de l'Atelier ANADEF)

### INFORMATIONS PRATIQUES

- **Site et coordonnées :** Au bord de l'océan, séparé uniquement par une dune, sur la côte des Landes, dans une région très «nature» du Pays Basque, formule résidentielle dans le Club Belambra de Seignosse « Les Tuquets » en logements de décoration contemporaine et fonctionnelle, accès WiFi.
- **Transport et accès :**  
**En avion**, aéroport de Biarritz à 40 km, aéroport de Bordeaux Mérignac à 170 km.  
**En train**, gare de Dax à 38 km.  
**En voiture :** A63, sortie 10, suivre N10, puis D810 (Coord. GPS lat.43.70466 GPS lon. : -1.432771)
- **Accueil sur site :** Le secrétariat sera ouvert le lundi 4 juin de 18h00 à 21h00 et du mardi 5 au vendredi 8 juin à partir de 8h00 et aux heures d'ouverture de l'Atelier.

### CONTACT

- **Votre contact pour toute information concernant votre inscription : Véronique LHEUREUX**  
ADERA Congrès – CS 60040 - 33608 Pessac - [atelier@adera.fr](mailto:atelier@adera.fr)

### MODALITES ET DROITS D'INSCRIPTION

- L'inscription s'effectue en ligne via le site [www.anadef.fr](http://www.anadef.fr). Elle est nominative. Aucune inscription partagée ne sera acceptée.
- Le montant de la participation inclut par jour :
  - Hébergement (1 nuit) / restauration (petit-déjeuner, pauses, déjeuner et dîner)
  - Participation à la conférence
  - Documentation, actes et liste des participants
- Un tarif préférentiel est accordé aux membres ANADEF à jour de leur cotisation 2018.
- Un tarif dégressif sera appliqué à partir de la 2<sup>ème</sup> inscription, pour l'inscription de plusieurs participants appartenant à la même entreprise et travaillant sur le même site.
- **L'inscription à l'Atelier 2018 peut être effectuée au titre de la formation continue (voir programme pédagogique en annexe).** La formation est conventionnée par ADERA – organisme de formation référencé sur le DATADOCK et enregistré sous le n° de déclaration d'activité formation 72 33 06982 33. L'inscription à la formation inclut la participation aux sessions plénières et tutoriels des 4 journées de l'Atelier, non dissociables (durée 3,5 jours – 22 heures de formation). L'inscription sera confirmée au retour de la convention de formation signée envoyée pour chaque inscription en formation.

	Membre ANADEF	Non membre - ANADEF	
1 <sup>ère</sup> inscription	1.555 € TTC	1.950 € TTC	<b>Formule tout compris : forfait hébergement, participation aux sessions, tutoriels et micro-ateliers, documentation</b>
2 <sup>ème</sup> inscription	1.400 € TTC	1.805 € TTC	

- **Date limite d'inscription :** les bulletins d'inscription devront parvenir à ADERA **au plus tard le 7 mai 2018**. Passée cette date, la réservation hôtelière n'est pas garantie sur le site de l'Atelier.
- Une confirmation d'inscription sera adressée à chaque participant.
- Assurez-vous qu'apparaît sur votre moyen de paiement la mention « Inscription à l'Atelier 2018 » ainsi que le nom du participant et celui de sa société ou de son organisme.
- L'accès à l'Atelier sera réservé aux participants ayant acquitté leurs droits d'inscription ou finalisé leur dossier au titre de la formation (convention de formation retournée signée à ADERA – [atelier@adera.fr](mailto:atelier@adera.fr))

**Annulation/Remboursement :** Toute annulation doit être faite par courrier électronique ([atelier@adera.fr](mailto:atelier@adera.fr)). Si l'annulation parvient à ADERA avant le 7 mai 2018, 160€ HT de frais de dossier seront retenus. Aucun remboursement ne sera effectué à partir du 8 mai 2018.

**Formation "Analyse et mécanismes de défaillance des composants pour l'électronique"**  
**ATELIER ANADEF 2018 - Village "Les Tuquets" Seignosse - Hossegor**  
**5/8 juin 2018 - durée : 3,5 jours - 22 heures**

**Mardi 5 juin 2018 - 6H00**

<b>9h30/1200</b>	Accueil - Techniques d'observation, de l'optique à la microscopie électronique
<b>14h00/15h30</b>	Asemblages et Packaging : interconnexions, PCBs & Multichips
<b>16h00/18h00</b>	Technologie VLSI et loi de Moore

**Mercredi 6 juin 2018 - 6h30**

<b>8h30/10h00</b>	Mécanismes de défaillance et fiabilité des VLSIs
<b>10h30/12h00</b>	Analyse de défaillance des circuits intégrés VLSI
<b>14h00/18h00</b>	Analyse de défaillance des composants optoélectroniques

**Jeudi 7 juin 2018 - 6h30**

<b>8h30/12h00</b>	Analyse de défaillance des LEDs et des diodes Laser
<b>14h00/15h30</b>	Composants de puissance émergents : SiC, GaN
<b>16h00/17h30</b>	Analyse de défaillance des composants de puissance (Si, SiC, GaN)

**Vendredi 8 juin 2018 - 3h30**

<b>8h30/10h00</b>	Diagnostic et signature électrique des structures élémentaires
<b>10h30/12h00</b>	Apport de la simulation à l'analyse de défaillance
<b>12h30/13h00</b>	Bilan - évaluation